



新闻动态

- ▶ 图片新闻
- ▶ 头条新闻
- ▶ 综合新闻
- ▶ 学术活动
- ▶ 科研动态
- ▶ 通知公告
- ▶ 业内信息
- ▶ 合作交流

现在位置: 首页 > 新闻动态 > 综合新闻

微电子所发起的首个硅通孔(TSV)技术攻关联合体在京成立

2011-08-17 | 编辑: 九室 张绪 | 【大】 【中】 【小】 【打印】 【关闭】

2011年7月9日,在国家02专项和中国封装测试联盟的支持下,由中国科学院微电子研究所发起的国内首个硅通孔(TSV)技术攻关联合体在北京宣告成立并启动了第1期攻关项目。科技部02专项责任专家于燮康,02专项专家组组长、中科院微电子所所长叶甜春以及近30家企业和科研单位代表参加了启动会。

会上,于燮康首先致辞并对联合体的运作及权责分配提出了相关建议。叶甜春对TSV技术攻关联合体的成立提出了希望,他表示这是对产学研结合的一种有益尝试,希望参加的多家企业能够相互之间实现部分资源的开放,相互合作,促进中国封测业的更好发展。中科院微电子所万里兮研究员和于大全研究员分别对TSV技术攻关联合体的总体情况以及本期联合攻关项目进行了介绍。会议还特别邀请了中科院国家科学图书馆的代表对TSV技术的专利布局和研究现状进行了总结。

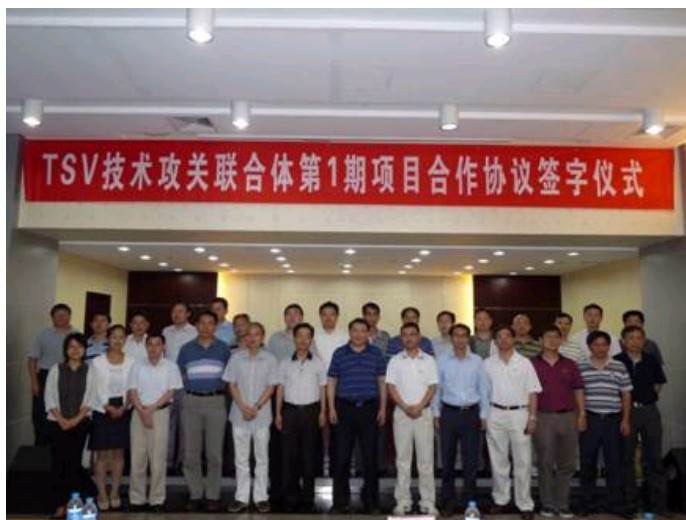
万里兮研究员在讲话时说指出,国内外目前普遍认为TSV技术是未来半导体技术发展的重要方向,但目前很多方面还不明确,尤其在产业化过程中还存在一些问题。此外,还存在着技术难点、成本偏高、代工企业与封测企业技术划分不确定、TSV技术产业链更长、实现难点多等问题。他明确表示,刚成立的技术攻关联合体要进行“竞争前技术研发”,不以达到高的技术指标为主要目的;第1期攻关项目主要是进行TSV转接板制备和封装集成;通过走通完整的技术流程,掌握设备、材料的真实需求(参数,型号等),了解技术难点(设备,材料,工艺),掌握投入、产出、成本等准确信息。通过全面的前期评估及技术实现,为企业是否进入该技术领域提供参考。于大全研究员详细介绍了本期研究课题及技术方案情况,根据开发基于TSV转接板的全套封装技术的攻关要求,介绍了初步拟定的技术方案,列出了典型加工流程所需的设备和材料,并介绍了本期联合体的基本管理方式。

各参会企业、高校和研究机构代表对TSV技术攻关联合体的成立及要开展的研究内容等问题进行了发言。大多数企业代表表示将加入该联合体,认为TSV技术攻关联合体的成立,提供了一个很好的平台,可以让企业能够以更低的成本、更快的速度、更好地了解技术需求,并及时对自身技术进行检验和评估。一些企业代表就关心的问题如“转接板的结构或工艺流程是否侵权、研究内容偏多如何完成、成本如何控制、成套资料内容构成”等进行了讨论。经过深入讨论,参会人员一致认为,第1期项目的主要研究目的应在于考察技术的可行性,评估技术实施的成本需求情况,最终主要成果除了封装样品之外,还需要提出全套的技术报告,为企业未来的技术选择做参考。

会后,十余家企业与中科院微电子所正式签订了加入TSV技术攻关联合体(第1期)的协议。



大会现场



合作协议签订仪式

附件下载:

相关新闻:

02专项“高密度三维系统级封装的关键技术研究”项目启动

我所参加“感知中国”服务于公安领域研讨会

微电子所在高端芯片国产化封装技术上取得重大突破



中国科学院微电子研究所版权所有 邮编: 100029

单位地址: 北京市朝阳区北土城西路3号, 电子邮件: webadmin@ime.ac.cn

京公网安备110402500036号